

製品出し方向

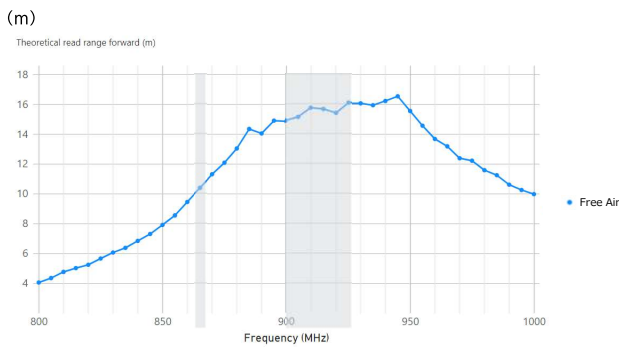
ラベル仕様

商品コード	062003581
デザイン名	STD 32×76/DT/7015M73
ラベルサイズ	P32*W76mm
セパサイズ	P36.51*W84mm
巻枚数	2,500枚/巻
ラベル基材	サーマル紙/強粘糊
推奨リボン	-
MOQ	2,500枚/箱
使用環境温度・湿度	温度 5~35℃ 湿度 40~80%RH以内
保管温度・湿度	温度 0~35℃ 湿度 30~70%RH以内

技術情報

アンテナサイズ	P15*W70mm
ICチップ	Impinj M730
メモリ容量	EPC:128bit/USER:0bit

周波数別パフォーマンス

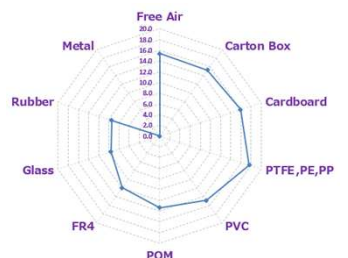


貼り付け素材別 通信距離目安 (m)

865MHz



920MHz



<各被着体>

Free Air : 自由空間
Carton Box : 段ボール
Cardboard : ポール紙(厚紙)
POM : ポリアセタール

PTFE,PP,PE : ベット系
PP : ポリプロピレン
PVC : 塩化ビニル樹脂
Metal : 金属

FR4 : ガラスエポキシ樹脂
Glass : ガラス
Rubber : ゴム

※電波暗室内での測定結果であり、実環境でのパフォーマンスを保证するものではありません。
※実環境使用時には、この値から1/3~1/2程度のパフォーマンスを目安としてください。

対応プリンタ



スキャントロニクス
CL4NX-J Plus



スキャントロニクス
CL4-SXR

株式会社サトー

お問い合わせ先

受付時間24時間365日

www.sato.co.jp



0120-226310

- ①RFID製品は、精密な半導体を搭載しており、環境によって読み取り性能等が大きく変化するものであることをご理解ください。
- ②製品を使用される前に、ご使用になる機器を用いて十分な実地試験を実施した上、お客様の判断で導入をお願いします。
- ③RFIDタグ・ラベルの最終的な貼り付け位置は、お客様にて確認・運用をお願いします。

- ・いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
- ・記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。

1. 本製品は、精密な半導体を搭載した製品であり、読み取り環境によって読み取り性能等が大きく変化するものであることをご理解下さい。例として、以下のような現象が発生することがありますため、これらの特性をご理解いただき、事前にお客様にてご使用の読み書き機器を用いて十分な実地試験を実施した上で、お客様のご判断にて導入をお願い致します。

- 金属製品や液体が入ったボトルなどに本製品を貼付する場合には、読み取りが困難になる場合があります。
- タグのアンテナに対する角度が変わると通信性能が変わることがあります。
- 周囲にノイズなどを発生させる電気・電子機器やその他金属製品があると通信性能が変わることがあります。
- 使用環境の温度・湿度によっては、通信が出来なくなることがあります。

なお、お客様のご要望に応じたカスタマイズ製品については、お客様と協議し事前に両方で合意した物理的仕様に従って生産し納品いたします。当社はお客様の使用環境における製品の各種性能(読み取り性能、耐久性能など)は保証できかねますので、導入前にあらかじめお客様でご検討頂き、最終の採用可否のご判断をお願いいたします。

2. データ書き込み途中の電力不足等に起因して、正常にデータの書き込みが完了しない場合がありますので、正常に書き込みが完了したことをご確認ください。

3. 運用・輸送・保管中の取り扱い環境や使用環境、外部ストレス(曲げ・圧力・静電気など)等によっては、本製品及びICチップの破損やICチップ内メモリのデータ化け等が生じる可能性がありますのでご注意ください。

4. 本製品に当社の責に帰すべき不具合が当社により認定された場合は、当社は不具合のある製品の数の代替製品を貴社に納入するものとします。本製品の不具合に関する当社の責任は代替製品の納入のみであり、損害賠償を含むその他事項については免責されるものとします。なお、当社は本製品の読み取りの精度につきましては、一切の責任を負わないものとします。

5. いかなる場合も、当社は、契約または不法行為に関する責任において、個々の契約の履行または不履行に関連して生じる利益または収益の損失または使用の中断、または間接的、特別、偶発的、結果的、懲罰的、または類似の損害に対して責任を負わないものとします。また、いかなる場合も、当社はお客様から個々の契約の下で受け取った金額の総額を超える責任を負わないものとします。

6. 本製品に使用する各基材やRFIDインレイ(ICチップ含む)等はメーカー都合により余儀なく生産終了となる可能性があります。

7. その他

- 天災その他の不可効力や不測の事態により納期遅延等が発生する場合は、当社は当該遅刻等に責任を負わず、別途行儀の上で対策を決めるものとします。
- 現在当社がご提案している仕様書に新たな要件項目を追加することが必要となった場合は、再見積を要する可能性があります。
- 為替変動等により再見積(価格改定)の可能性があります。